

证券代码：603061

证券简称：金海通

天津金海通半导体设备股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关 系活动类 别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场访谈 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 线上分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 线上调研
参与单位 名称	特定对象调研、线上调研：易方达、南方基金、湖南源乘私募、理臻投资、宁波敦和投资、中信保诚基金、循远资产、中泰证券、北京紫薇私募、北京源乐晟资产、方正自营、华宝基金、华西证券、中金公司、招商信诺、上海途灵资产、上海仙人掌私募、交银施罗德基金、上海瓦洛兰投资、上海五地私募、财通资管、摩根基金、广东正圆私募、长安基金、北京磐泽资产、长城财富保险资管、上海道仁资产、上海保银私募、贝莱德投资、山西证券、华泰证券、东亚前海证券、华龙证券、国华兴益保险资产、浦银安盛、上海摩旗投资、上海健顺投资、浩成资产、北京衍航投资、上海常春藤私募、鹏扬基金、Point72、长盛基金、青骊投资、信达澳亚基金、上海非马投资、国金证券、光信私募基金、湖南省财信信托、金鹰基金、海富通基金、上海易正朗投资、兴银基金、东方证券资管、上海盘京投资、北京市星石投资、中邮证券、华泰柏瑞、开源证券、西部证券、中欧基金、浙商证券、浩期资产、国海证券、太平资产、长信基金、中信建投基金、国信自营、中信资管、国寿安保基金、宏利基金、兴合基金、泉果基金、华夏基金、新华基金、中金资管、民生加银、泰康资产、天弘基金、中邮基金、兴业证券、招商基金、华福证券、国盛证券、摩根资管、摩根大通证券、天风证券、润晖投资、兴银理财、东方证券自营、华富基金、南京证券资管、鹤禧投资、上海润义投资、博时基金、华安基金、国寿资产、瓴仁投资、长江	

	<p>证券（以上排名不分先后）；</p> <p>业绩说明会：参与业绩说明会的投资者。</p>
时间	2026年3月11日至2026年3月30日
地点	公司会议室、腾讯会议、策略会现场、路演现场、上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com ）。
上市公司接待人员姓名	<p>特定对象调研、线上调研：副总经理兼董事会秘书刘海龙先生；</p> <p>业绩说明会：董事长兼总经理崔学峰先生、独立董事孙晓伟先生、副总经理兼董事会秘书刘海龙先生、财务总监黄洁女士。</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍主要内容</p> <p>金海通的主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售，客户群体涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM企业（半导体设计制造一体化厂商）、芯片设计公司等。公司产品在集成电路封测行业有较高的知名度和认可度，产品遍布中国大陆、中国台湾、东南亚、欧美等全球市场。</p> <p>公司自成立以来，一直坚持深耕集成电路测试分选机的研发、生产和销售。公司深耕平移式测试分选机领域，产品根据可测试工位、测试环境等测试分选需求分为EXCEED-6000系列、EXCEED-8000系列、EXCEED-9000系列、SUMMIT系列、COLLIE系列、NEOCEED系列等。</p> <p>公司的核心技术集中于“高速运动姿态自适应控制技术”、“高兼容性上下料技术”、“高精度温控技术”、“芯片全周期流程监控技术”等领域。公司产品的软件定制化程度高，集成程度高，反馈速度快，技术支持响应度好；产品的UPH（单位小时产出）、Jam rate（故障停机率）、可并行测试最大工位等指标已达到同类产品的国际先进水平。</p> <p>二、公司2025年年度经营情况介绍</p> <p>受公司所在的半导体封装和测试设备领域需求回暖等因素影响，公司2025年实现营业收入6.98亿元，较上年增长71.68%；实现归属于上市公司股东的净利润1.77亿元，较上年增长124.93%；2025年，公司实现剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润1.99亿</p>

元，较上年增长 128.26%。

2025 年度，公司管理费用较上年增长 44.97%，主要系股份支付费用、资产折旧费用的增加所致；销售费用较上年增长 28.25%；研发费用较上年增长 43.36%，主要系股份支付费用的增加、研发人员的增加所致；财务费用较上年增长 130.20%，主要系汇兑净损失增加所致。2025 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 1.28 亿元，较上年增加 116.68%。截至 2025 年末，公司总资产为 21.50 亿元，较上年末增长 34.47%；净资产为 16.14 亿元，较上年末增长 22.64%。

产品方面，公司持续升级现有产品，2025 年，公司完成三温测试分选机及大平台超多工位测试分选机等机型的升级迭代。针对于汽车电子芯片等的三温测试需求，2025 年公司推出效率更高的 32site（32 工位并行测试）三温测试分选机；针对于常高温大平台超多工位测试分选机，公司在既有 EXCEED-9032 系列产品基础上推出升级版，支持 32site（32 工位并行测试）独立控温测试，可实现连续 10 小时无故障运行，大幅优化设备稳定性并提高测试产能。

市场推广方面，公司保持以技术为核心的策略，进一步扩大现有市场，逐步建立起规模优势。在新开发的客户市场，依靠自身技术优势，针对客户的定制化需求，提供更优质的服务，逐步形成品牌效应，获得新的发展。

公司“马来西亚生产运营中心”已于 2025 年上半年正式启用，助力公司更好地贴近市场和客户、响应客户需求。

三、调研问答

1、问：产品更新迭代有什么进展？

答：公司持续深耕产品创新与技术迭代升级，不断强化技术壁垒与产品竞争力，公司持续对现有产品在温度控制、并测工位、可测试芯片尺寸、上下料方式和压力控制等方面进行技术研发和产品迭代。2025 年，公司完成三温测试分选机及大平台超多工位测试分选机等机型的升级迭代。针对于汽车电子芯片等的三温测试需求，2025 年公司推出效率更高的 32site（32 工位并行测试）三温测试分选机；针对于常高温大平台超多工位测试分选机，公司在既有 EXCEED-9032 系列产品基础上推出升级版，支持 32site（32 工位并行测试）独立控温测试，可实

现连续 10 小时无故障运行，大幅优化设备稳定性并提高测试产能。

同时，公司持续跟进集成电路测试分选行业细分领域头部客户的前瞻性的测试分选需求，通过深度定制化开发掌握并持续积淀特定细分领域芯片测试分选的前沿技术，持续扩容公司动态演进的技术储备池。2025 年，公司产品测试分选机新增高速 Tray scan（料盘扫描）检测、无人化工厂软硬件适配、芯片抗氧化保护等功能。

公司适用于 MEMS 的测试分选平台、适用于碳化硅及 IGBT 的测试分选平台以及专用于先进封装产品的测试分选平台已经在多个客户现场进行产品验证。同时，对于适用于 Memory 的测试分选平台，公司在既有技术储备的基础上持续关注细分市场不断变化的测试分选需求。

2、问：从产品结构上看，2025 年度有什么变化？

答：2025 年，EXCEED-9000 系列（EXCEED-9800 系列、EXCEED-9032 系列）产品产生的收入占营业收入总额的比重继续提升至 38.98%，2024 年为 25.80%。

3、问：本期业绩增长主要原因？

2025 年，公司所在的半导体封装和测试设备领域需求回暖，三温测试分选机及大平台超多工位测试分选机（针对于效率要求更高的大规模、复杂测试）需求持续增长，公司测试分选机产品销量实现较大提升。公司 2025 年实现营业收入 6.98 亿元，较上年增长 71.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.77 亿元，较上年增长 124.93%。

4、问：公司对目前行业的发展趋势感知如何？

答：在技术迭代、需求提升、场景渗透等因素的多重驱动下，2025 年全球半导体行业延续增长态势，先进封装、AI 及高性能计算等需求的增长给半导体设备带来广阔的市场空间。半导体行业协会（SIA）数据显示，2025 年全球半导体销售额达到 7,917 亿美元，较 2024 年同比增长 25.6%，创历史新高。此前世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测，2025 年全球半导体市场规模预计同比增长 22.5%。上述驱动因素动能的持续释放，将推动未来几年全球半导体行业持续快速发展。

特别是随着先进封装、AI 算力芯片等的发展，相关芯片测试的复

杂度在攀升，芯片测试总耗时大幅提高，对高端测试资源的需求在快速增加；与此同时，相关芯片的测试在温度控制、热管理效率及动态适配能力等方面，对半导体测试分选设备提出了更高的要求。半导体测试设备公司已进入快速发展新阶段。

5、问：人员数量有什么变化？

答：截至 2025 年末，公司员工共计 451 人，较上年末小幅增长 23.56%。目前公司管理体系仍相对灵活，未来将结合生产经营、研发进展、客户端需求等实际情况进行人员规划。

6、公司一般情况下交货周期如何？

答：一般情况下，客户会与公司进行持续性的常态化沟通，对公司产品的技术指标及交货周期等进行了解。对于量产机型及标准选配功能，公司具有快速交货能力。

7、问：决定购买测试分选设备的是芯片设计公司还是测试代工厂？

答：两种情况都有，具体要看产品和项目情况。对于量产机型，测试代工厂的话语权会相对多一些；但是对于芯片设计公司有特别测试需求的产品如算力芯片等，芯片设计公司主导测试分选设备的评估，在这种情况下，芯片设计公司通常会直接或者通过测试代工厂与公司沟通设备技术指标等需求。

四、业绩说明会问答

1、问：公司本次分红情况能否再文字介绍一下？

答：尊敬的投资者，您好！

本次利润分配方案如下：

1、现金分红：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.38 元（含税）。截至当前，公司总股本 60,000,000 股，公司拟合计派发的现金分红总金额为 22,800,000.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 12.92%。

2、资本公积转增股本：公司以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.5 股。截至当前，公司总股本为 60,000,000 股，本次以资本公积转增股本后，公司的总股本为 87,000,000 股（最终以中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准)。本次转增通过“资本公积——股本溢价”科目进行转增。

如自议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本数量发生变动的,则公司拟维持每股分配比例、每股资本公积转增比例不变,相应调整现金分红、转增股份总额,具体调整情况将另行公告,调整后的利润分配方案无需再次提交董事会及股东会审议。

本次利润分配方案尚需公司 2025 年年度股东会审议。

感谢您的关注!

2、问:公司在 2026 年有没有一些 AI、大模型方向的投入或者合作?

答:尊敬的投资者,您好!

公司主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售,客户群体涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM 企业(半导体设计制造一体化厂商)、芯片设计公司等。公司的产品在集成电路封测行业有较高的知名度和认可度,产品遍布中国大陆、中国台湾、东南亚、欧美等全球市场。

未来,公司将继续专注服务半导体封装测试行业,在集成电路测试分选领域深耕,不断加强自主技术创新能力,向更广的测试温度范围、更多并测工位、更多类型的产品测试等方面进一步创新和发展来满足更多类型的测试分选需求,努力拓宽客户群体和市场,更好地服务客户。

公司产品与客户具体合作情况以公司在指定信息披露渠道披露的相关公告为准。敬请投资者谨慎注意投资风险。感谢您的关注!

3、问:公司发布年度业绩报告次日,二级市场股价出现跌停。请问管理层如何看待本次股价大幅波动?是否与分红方案、应收账款规模及回款预期等因素相关?未来是否会采取相应措施加强投资者沟通、优化现金流管理,并积极开展市值管理工作,以维护公司估值与中小股东利益?

答:尊敬的投资者,您好!

二级市场股价短期波动受宏观环境、行业情绪、资金行为等多重因素综合影响。

公司主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售,主要

	<p>为半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM 企业（半导体设计制造一体化厂商）、芯片设计公司等提供自动化测试设备中的测试分选机及相关定制化设备，公司经营基本面稳健。</p> <p>公司将紧密结合市场需求，持续深耕产品创新与技术迭代升级，不断强化技术壁垒与核心竞争力，深化全球市场布局。在扎实做好主营业务的同时，公司将持续加强应收账款管理与内部控制，不断提升运营效率与综合竞争力。</p> <p>公司始终高度重视投资者关系管理与市值管理工作，坚持规范运作，持续提升公司治理水平，持续提高信息披露质量和透明度，传播公司内在价值，持续加强与广大投资者尤其是中小股东的沟通交流，切实维护全体股东长远利益。</p> <p>敬请投资者谨慎注意投资风险。感谢您的关注！</p>
附件清单 (如有)	无
风险提示	<p>以上如涉及公司所处行业发展趋势、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业发展、公司发展或业绩的预测和承诺，不构成公司或公司管理层对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。</p>
日期	2026 年 4 月 1 日